

東証PRM

268A

リガク・ホールディングス株式会社

Sector; 精密機器

2025/12/9

革新的なX線分析技術で半導体をはじめ多様な産業分野の進化を支える、日本が誇るグローバル・リーディングカンパニー！！

会社概要

代表取締役社長 CEO	川上 潤	https://rigaku-holdings.com
本社	〒196-8666 東京都昭島市松原町3-9-12	
設立	2020年12月7日（主要事業会社の株式会社リガクは1951年12月設立）	
上場	2024年10月	
事業内容	X線による回折・分析機器（含・ソフトウェア）等の開発・製造・販売・アフターサービス	
拠点展開	国内（本社、製造拠点）に加え、北米5拠点、アジア5拠点、欧州・中東5拠点	
発行済み株式数	229,947,800株（内自己株1,740,801株：2025年3Q末）	
主要株主	Atom Investment, L., P. 95,140,800株 41.49%	
	2025年3月末 志村 晶 27,476,600株 11.98%	
	日本マスタートラスト信託銀行（信託口） 17,954,200株 7.83%	
	日本カストディ銀行（信託口） 5,229,700株 2.28%	
	INDUS SELECT MASTER FUND 4,995,600株 2.18%	
	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 4,160,350株 1.81%	
	NORTHERN TRUST CO. 2,726,000株 1.19%	
	MSCO CUSTOMER SECURITIES 2,641,256株 1.15%	

株価データ

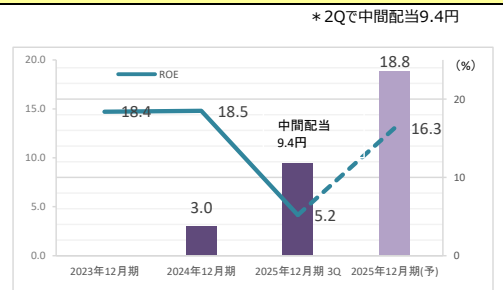
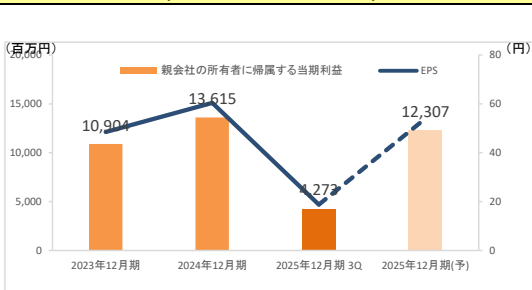
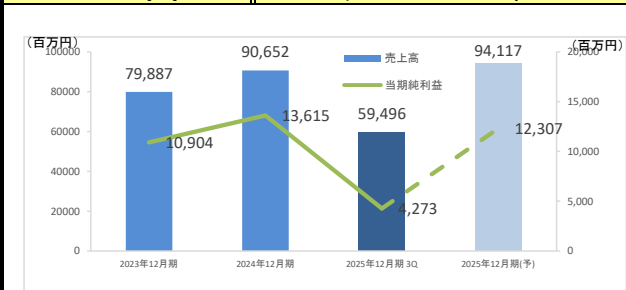
2025/12/8

終値	1,152円
予想PER	21.2倍
実績PBR（実績）	3.2倍
時価総額	2,650億円
出来高10日平均	2,300百万円
売買単位	100株
株主優待制度 *100株以上	無し



<https://finance.yahoo.co.jp/quote/268A/T/>

	売上高 (百万円)	営業利益	税引前利益	当期純利益 (百万円)	親会社の所有者に帰属する当期利益 (百万円)	EPS (円)	ROE (%)	配当 (円)
2023年12月期	79,887	15,256	14,826	10,904	10,904	48.4	18.4	0.0
2024年12月期	90,652	18,367	17,977	13,615	13,615	60.4	18.5	3.0
2025年12月期 3Q	59,496	6,562	6,095	4,273	4,273	18.8	5.2	9.4
2025年12月期(予)	94,117	18,145	17,397	12,307	12,307	54.0	16.3	18.8



【会社概要】

当社リガク・ホールディングスは、2020年12月に株式会社リガクの買収を目的として設立され、グループの主要な事業会社である株式会社リガクは1951年12月に東京都千代田区有楽町に国産のX線装置の製造・販売を事業目的に理学電機(株)(現 (株)リガク)として設立された。1960年に東京都昭島市に拝島工場を開設、1971年には米国マサチューセッツ州にRigaku USAを設立。その後国内拠点を拡充し、1990年には山梨県北斗市に須玉工場を新設、翌年には昭島市に(株)リガク X線研究所を新設。1996年には米国のMolecular Structure Corporationを買収し翌年には米国のOsmic, Inc(現 Rigaku Americas Holding, Inc.)を買収。2008年にはチェコスロバキアに連結子会社を設立し、2009年には中国北京市に連結子会社を設立2010年には香港に連結子会社を設立、同年ドイツベルリンにもRigaku Europeを設立しグローバル展開を拡張。2013年にはブラジルサンパウロ市にRigaku Latin America Ltda.を設立、2015年にはポーランドに連結子会社を設立、2016にシンガポールに連結子会社を設立、2019年にイスラエルも連結子会社を設立し、グローバル展開を積極推進。2021年1月に、米カーライルグループと旧志村社長との共同出資による持株会社を設立(カーライル約80%、志村氏約20%)し、リガクの発行済み株式を株式交換により全株取得し、グローバル展開を加速させ企業価値を高め上場を目指す目的でパイアウツを実施。その後、本社を東京都昭島市松原に移し、グループ企業の再編や、海外拠点展開をM&Aや子会社設立により積極的に実施(オランダ、英国、フランス、上海、インド、台湾)し、2024年10月に東証プライム市場に公募価格1,260円、時価総額2,830億円で大型銘柄として上場を果たした。リガクグループは、理化学機器の専門メーカーとして創業から70年を超える歴史を通じて培われた卓越した技術をベースに、国内のみならず90か国を超える世界各国にX線回折、蛍光X線分析、X線イメージング等、X線技術を中心とした分析・計測機器の開発から製造、販売、サービス等の事業を国内外の連結子会社17社で展開している。X線回折機器(XRD)の業界シェアは、国内では圧倒的No1で、グローバルにおいてもNo2のポジションで、半導体前工程向けX線計測機器シェアにおいてはグローバルNo1のシェアを誇る。半導体業界におけるリガクグループの取引先はグローバル上位10社を顧客に抱え、製薬業界においては国内上位10社が顧客で、化学製品業界においても国内上位10社が当社グループの顧客である。当社の事業セグメントは、3つに分かれており、①：X線技術を利用した分析・計測機器の開発や製造・販売を大学・研究機関や幅広いエンドマーケットの多様な研究開発ニーズにお応えする多目的分析機器事業、②栄光X線(XRF)、X線反射率(XRR)、X線回折(XRD)などの分析手法を組み合わせ、半導体ウェーハの汚染検査など半導体製造におけるさまざまなパラメータの測定によりプロセスをコントロールする工程で利用される半導体プロセス・コントロール事業、③販売した製品の消耗品・交換部品の供給、予防保守契約などを提供し、アフターサービスを製品のライフサイクルにわたって継続的に提供する部品・サービス事業の3つのセグメントに分かれている。2024年12月期の売上高906億円のうち46%が多目的分析機器事業、26%が半導体プロセス・コントロール機器事業、29%が部品・サービス事業となっている。営業利益183億円の構成では、多目的分析機器事業が35%、半導体プロセス・コントロール事業が36%、部品・サービス事業が30%の構成割合となっており、半導体コントロール・プロセス事業の営業利益率が最も高く、全社の営業利益率も高い技術力と製品力に裏付けされた、営業利益率20. %超と高い収益体質の企業といえる。X線回折機器(XRD)における2023年度の国内シェアは77%と圧倒的で、グローバル市場においても2024年度調査レポートによると、当社を含む3社で70%の寡占状況の中で、当社シェアは26%と競合A社28%に次ぐ2位となっている。2025年度の業績計画については、連結売上高941億円、営業利益181億円、当期純利益123億円を計画している。配当については、配当性向30%を目途としており18.8円(前期3円)を計画している。11月14日に第3四半期の決算発表を実施している。3Q自体の数値は、通期業績予想に対しては、かなり、ビハインドしているように見えるが、会社側としては想定通りの売上であったが、営業利益ベースではやや想定を上回るビハインドとなったため、3Qが底で4Qの回復と通期業績着地について詳細に説明している。多目的機器事業については、年末に向けた大幅売上増が見込まれ、利益率の改善が進む見込みである。半導体プロセス・コントロール機器事業においては、新製品の納品が4Qに多く見込んでもおり製品ミックスによる大幅な増収・増益を計画している。部品・サービス事業においてはEUUV向け多層ミラーの売上減と利益率への影響があるが、他部品や堅調なサービスで4Q以降回復する見込みで、その確度も積み上げで高いものがあると会社は自信を持っている。これにより、今期業績予想は計画通りに着地する見込みで、来年度の方角性についても外部環境認識として、多目的分析機器分野は2025年が底で2026年は回復する見込みで、半導体プロセス・コントロール機器事業環境は、AIの浸透・進化がドライバーとなり世界の半導体投資が足元で加速しており、旺盛な需要が見込まれるとみている。部品・サービス事業についても事業環境は好転すると見ており、全社的に新製品開発は順調で生産拡大に向けた投資も完了し、収益貢献も開始してきており、中期経営計画の戦略に変更はなく中長期の企業価値向上に向けて邁進する方向性で、増配に加え自社

【事業成長戦略・Valuation】

リガクグループは「科学技術の進歩を通して人類社会の発展に貢献する」という企業理念のもと、X線分析機器の開発・製造・販売の専門メーカーとしてグローバル市場において成長してきた。長年培われた要素技術力と、開発から製造・販売・サービスまで内製化し、グローバルに展開する半導体をはじめとしたあらゆる産業分野における有力な顧客基盤と高い顧客ロイヤルティによる世界のイノベーションを支える企業として成長している。現在推進中の中期経営計画におけるコア戦略となっている「Lab to Fab」は要素技術を基盤に、研究開発領域(Lab)で確立した回折技術をより大きな市場である生産領域(Fab)への展開していくという戦略である。アカデミアやインダストリー分野において、研究所から生産現場までに計測装置が波及していく技術的連続性は、新たなイノベーションの起点となっており、技術の核は共通しているものの、求められる性能は生産現場では大きく異なり市場も大きく拡大する領域となる。また、生産現場での安定的な稼働を支える予防保守や復旧体制のニーズもあり、当社の部品・サービス事業の領域も拡大している。Lab to Fab戦略を軸とした持続的な成長を目指し、「三本の矢」として、Pillar1, Pillar2, Pillar3を中心に推進している。Pillar1は、基盤技術の深化とグローバル展開で、多目的分析機器事業におけるX線回折(XRD)や蛍光X線分析(XRF)などの研究用とから産業用途まで幅広くグローバルに展開する戦略である。Pillar2は、半導体の次世代構造への対応と新市場創出に向けた取り組みで、大きな成長ドライバーとして推進している。AIチップやパッケージング技術の進化により、次世代構造に対応した高精度のX線評価技術の開発を進め、半導体X線計測機器市場におけるグローバルリーダーの地位を確固たるものにし、継続成長を目指していく戦略である。Pillar3は、未開拓市場への挑戦である。SiCやGaNなどの次世代材料、電池材料、ライフサイエンス分野においてもX線技術の応用が期待されており、こうした新たな分野におけるアプリケーション開発を推進していくものである。特にPillar2における半導体プロセス・コントロール事業においては、2026年から開発中のパイプラインから新製品も続々と市場投入されていく計画で、売上と共に製品MIXによる収益性の向上も期待できる。現行の中期経営計画の最終年度となる2027年12月期の数値目標は、売上高1,150億円～1,200億円(CAGR約10%)、調整後EBITDAは315億円～325億円、調整後営業利益265億円～275億円 で営業利益率約23%を設定している。成長に向けた投資として、研究開発費比率は約9%、設備投資額比率は約5%を計画している。

Corporate analysis by IR STREET

Strength

- 高い技術力・製品競争力：XRD/XRFなどコア技術で長年の実績と高い技術蓄積を背景とした装置、ソフト提供
- 知的財産・グローバル展開：蓄積された特許・ノウハウとグローバル大手企業への浸透と取引拡大が継続

Weakness

- AI・半導体の旺盛な投資による高精度計測ニーズの継続
- 電池・エネルギーや次世代材料開発等のイノベーション開発への材料改正装置需要の拡大

Opportunity

- 幅広い顧客層の中で、半導体産業をはじめ業界の景気循環性による影響を受ける可能性あり
- グローバル大手競合との競合の中での優位性の維持確保

Risk

- マクロ経済による景気的大幅な後退
- 地政学リスク、各国の規制等のリスク

